

Ferri 嵌入式存储

开启 AI 时代的智能嵌入式存储解决方案



目录

关于慧荣 —— 2

Ferri 嵌入式存储 —— 3

应用 —— 5

FerriSSD[®] —— 7

Ferri-eMMC[®] —— 9

Ferri-UFS[®] —— 11

选购指南 —— 13

联系我们 —— 22

关于慧荣

慧荣科技股份有限公司 (Silicon Motion Technology Corp., Nasdaq GS:SIMO)，以下简称慧荣科技，1995 年成立于美国加州硅谷，2005 年在 NASDAQ 上市。在中国大陆、台湾、香港和美国地区等均设有企业办公室，为全球客户提供主控芯片及相关技术服务。

慧荣科技长期专注于 NAND Flash 主控芯片的设计与开发，在 SSD、智能手机、PC、数据中心、工业控制及商用设备等领域积累了丰富的技术经验。依托对 NAND Flash 架构的深入理解，公司构建了完善的主控芯片 IP 体系，可用于开发搭载固件的主控平台 IC，并提供配套的 Turnkey 方案，以协助客户提升产品稳定性与整体效率。

公司的主控芯片能够支持多家 NAND 厂商的产品，包括 YMTC、Micron、Samsung、SK Hynix、KIOXIA、SanDisk 等不同品牌与多代结构的 3D TLC/QLC 闪存。通过持续研发投入与技术服务，公司与 NAND 制造商、存储模组厂及多类 OEM 客户保持着稳步合作。

在国内市场，慧荣科技与多家知名存储品牌建立了长期合作关系，推动多款存储产品的开发与量产。同时，面向企业级存储应用，公司提供可定制的 SSD 主控解决方案，相关产品已在部分大型数据中心中投入实际使用，为多样化的数据应用提供存储支持。

公司也为工业控制与车载应用市场提供高性能、小尺寸的嵌入式主控芯片，以及单芯片 SSD、eMMC 和 UFS 解决方案，已广泛应用于多家国产、美系与日系整车厂。

慧荣科技持续专注于技术创新与产品研发，以应对不断变化的市场需求，并为客户提供可靠的产品与解决方案，协助其提升系统性能与整体价值。



Ferri 嵌入式存储

慧荣科技的 Ferri 嵌入式存储系列 — 包括 FerriSSD®、Ferri-eMMC® 和 Ferri-UFS® 专为关键任务型存储应用打造，采用紧凑易集成的设计，提供高性能、卓越可靠性及先进安全性。随着 AI 驱动的应用在汽车、工业自动化、服务器、电信、游戏、监控设备和医疗等领域持续扩展，Ferri 解决方案经过优化，能够满足对高速数据访问、低功耗与增强耐久性的不断增长的需求。



Ferri 提供涵盖单芯片 SSD 和 SSD 模块，以及 eMMC 和 UFS 产品的完整解决方案，实现跨多种嵌入式和汽车平台的无缝集成。凭借成熟、可扩展且具备量产能力的解决方案，Ferri 确保了超低的 DPPM 质量筛查和较长的产品生命周期，在降低总体拥有成本的同时，最大限度地提升系统运行时间。

Ferri 产品采用慧荣科技的多项独有技术，包括 IntelligentSeries™、DefendMax™ 和 NANDXtend®，即使在最严苛的环境下，也能提供稳健的数据完整性、强效的安全防护以及出色的可靠性。

IntelligentSeries™ 先进数据保护技术

Ferri 嵌入式存储具备一套智能数据保护机制，能够满足不同应用系统的存储需求，并在各种可能发生数据丢失的环境中有效激活。



IntelligentLog™

汽车/服务器智能技术和主动警告



IntelligentGuard™

经验证固件保护的数据加密



IntelligentThermal™

HCTM / DCTM (热管理)



IntelligentFlush™

Power Flush 技术提高稳定快速的写入性能



IntelligentImage™

图像内容预加载 (SMT 回流焊)



IntelligentZones™

耐用性组 - 多命名空间等功能



IntelligentScan™

主动数据保护



IntelligentShield™

电源中断保护



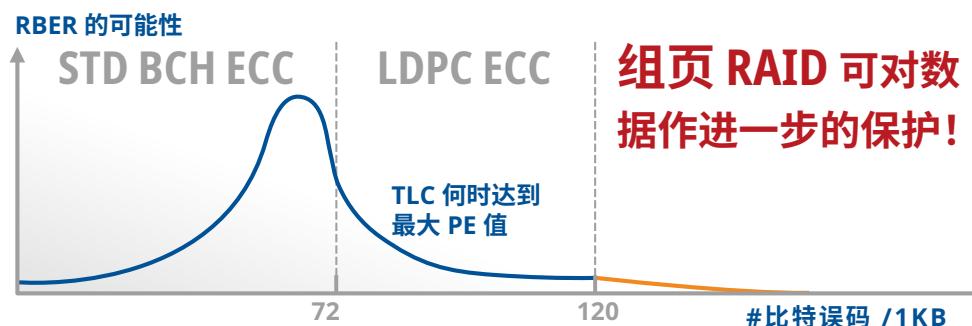
了解更多

DefendMax™ 用于严苛应用中安全可靠的启动驱动

配备 DefendMax™ 的 FerriSSD® 为关键任务和严苛环境应用提供强大的安全性和可靠性。其集成 IntelligentGuard™ 固件保护、IntelligentShield™ 断电数据防护和 IntelligentThermal™ 温度控制，确保在恶劣环境下实现稳定运行。结合 NANDXtend® ECC 和端对端数据路径保护，FerriSSD® 提供卓越的数据完整性和可靠的系统运行保障。

NANDXtend® ECC 技术，延长 SSD 使用寿命

NANDXtend® 是慧荣科技为 3D NAND 固态硬盘设计的先进固件，结合了 LDPC 和 RAID 校正技术，实现了精准且高速的纠错功能。其三级算法显著提升了 P/E 循环性能，延长了 SSD 的使用寿命，同时确保了数据的完整性。



应用

汽车



Ferri 嵌入式存储为汽车应用提供高性能、可靠性和耐用性，包括先进驾驶辅助系统 (ADAS)、自动驾驶、智能座舱和车联网 (V2X) 连接等场景。通过 AEC-Q100 认证、IntelligentSeries™ 技术和可定制固件，Ferri 能够在严苛的汽车环境中实现快速数据处理、安全存储和长期稳定运行。

工业自动化



Ferri 嵌入式存储解决方案赋能 AI 驱动的工业自动化，支持边缘计算、机器视觉、预测性维护、机器人和自主移动机器人 (AMR) 等应用。凭借高速数据吞吐量、出色的耐用性和可定制固件，Ferri 在新一代智能制造中实现实时数据分析、自主导航和高效工厂运作。

服务器



FerriSSD® 专为服务器启动应用而设计，具备快速启动、卓越的可靠性和出色的数据保护能力。通过集成 IntelligentScan™、DataRefresh™ 和 FastWrite™ 等技术，FerriSSD® 确保无差错运行、有效防止断电数据丢失，并延长产品耐用性。其小型的 BGA 封装可轻松适配空间受限的服务器环境，结合超低 DPPM 筛选和远程固件更新支持，成为一款稳定、高效且具成本效益的启动驱动器解决方案。

POS/自助服务亭 (Kiosk)/数字标牌



Ferri 嵌入式存储解决方案为 POS 系统、Kiosk 自助服务亭和数字标牌提供快速启动、稳定性能和长期可靠性。凭借低功耗设计、高效数据管理能力和现场可编程固件，Ferri 可在 24/7 全天候运行环境中保障系统稳定，并支持便捷的远程更新。

通信/网络



Ferri 为 5G 基站、路由器、交换机和各类网络设备提供高速、安全、可靠的存储解决方案。Ferri 专为低延迟和长期耐用性设计，确保在电信和企业网络基础设施中实现高效数据缓存、网络优化和流畅的数据包处理。

监控设备



Ferri 嵌入式存储支持高分辨率视频录制、分析和 AI 驱动的监控应用，具备高性能、耐用性和安全性。Ferri 是网络摄像头、NVR 和智能监控系统的理想选择，即使在严苛环境中，也能实现实时数据采集、可靠存储和长期数据留存。

游戏机



Ferri 嵌入式存储为赌场和游戏应用提供安全、可靠且高性能的解决方案，涵盖老虎机、桌上游戏、街机系统、游戏控制中心、酒店自助服务终端机、显示屏、监控系统和服务器等。Ferri 通过 AES-256 加密、固件保护和 NANDXtend® ECC，确保现代游戏环境下的数据安全、24/7 全天候可靠运行和长生命周期支持。

医疗



Ferri 嵌入式存储为医疗设备提供安全、可靠且高性能的解决方案，适用于成像系统、患者监护仪、诊断设备和便携式医疗终端等。通过集成 AES-256 加密、固件保护和 NANDXtend® ECC 技术，Ferri 在关键任务医疗应用中保障数据安全、系统稳定运行和长期可靠性。

Ferri-SSD®

单芯片 SSD



随着人工智能在 AIoT（智慧物联网）、智慧城市、智慧医疗、智慧零售、工业自动化和汽车等行业的广泛应用，对高性能、低功耗且可靠的 BGA SSD 的需求愈加迫切。FerriSSD® 搭载慧荣科技的 IntelligentSeries™ 技术，为关键性人工智能应用提供了强大的存储解决方案，即便在极端环境下，也能确保卓越的数据完整性、耐用性和安全性。

FerriSSD® 专为工业和汽车应用设计，支持 PCIe Gen 4 x4，并将高容量 3D NAND 集成至紧凑型 16mm x 20mm BGA 封装中。它提供最高 1TB 的存储空间，具备超过 6GB/s 的读取速度和超过 650MB/s 的写入速度，确保数据处理的可靠性与高性能。这些特点使 FerriSSD® 成为对性能、可靠性和安全性要求极高的人工智能应用的理想选择。

FerriSSD® 通过支持宽温范围和灵活的存储容量，针对广泛应用场景进行了优化。其易于整合的特点加速了部署过程，而精巧尺寸设计、结合认证的主控芯片技术、NAND 闪存和无源组件的优势，则简化了系统设计，缩短了上市时间，并有效应对了 NAND 迁移带来的挑战。

此外，FerriSSD® 还采用慧荣科技独有的 NANDxtend® ECC 技术及端对端数据保护，提供了企业级的数据完整性与可靠性。它支持安全的远程固件更新，保障了系统的持续安全，而其内置 SR-IOV 功能则带来更大的灵活性和可扩展性，确保在跨应用程序中的强大安全性。

特点

双 ARM® Cortex® R8 CPU

eFuse 的数字签名固件增强安全性 (可选)

数据可靠性

- 性能优化的 LDPC 引擎具备最强大的纠错能力
- 具有 CRC 奇偶校验的端到端数据路径保护
- RAID 引擎为 NAND 闪存数据提供多页面保护

数据完整性和安全性

- 内置 AES-128/256 加密
- TCG Opal v2.01 规范
- 内置硬件 SHA384 和 True Random Number Generator (TRNG)

强大的数据保护

- 针对不稳定电源的高级系统级保护
- StaticDataRefresh™ 和 EarlyRetirement™ 技术可确保数据的完整性并防止读取干扰
- PowerShield™ 和 DataPhoenix™ 技术支持断电数据保护和恢复

先进的全区磨损均衡 (Global Wear Leveling) 技术

- 充分利用每个单元来平均跨管理单元/芯片的写入/擦除数
- 以最小的耗损和写入放大，延长产品使用期限

SSD 状态监控

- 支持通过 Get Log Page 命令的 SMART/Telemetry 功能监控 SSD 状态
- 支持 FerriSSD® 专利的 IntelligentLog™ 以进行有效的事件跟踪

电源和热管理

- 支持主机控制热管理 (HCTM) 以配置热控温度
- 支持设备自热管理
- 支持不同的电源状态 (PS0、PS1、PS2、PS3、PS4)

Ferri-UFS®

工业/车用 UFS 内存



随着人工智能迅速扩展至汽车、智慧医疗、智慧城市、工业自动化、智慧零售和 AIoT（智慧物联网）等领域，对高性能、节能且可靠的存储解决方案的需求变得尤为迫切。这些行业中的人工智能驱动应用需要快速的数据访问与处理，以支持实时决策和多任务操作，这使得 UFS 技术成为这些先进系统不可或缺的核心。

Ferri-UFS® 搭载慧荣科技的 IntelligentSeries™ 技术，即使在最严苛的环境下，也能提供卓越的性能、数据完整性、耐用性和安全性，满足这些行业的严格要求。

Ferri-UFS® 专为高性能数据传输、卓越的功率效率和无缝整合而设计，采用先进的 NAND 管理技术，支持 UFS 3.1 高级功能（如 HS-Gear4 双通道模式和命令队列），实现快速的数据处理和高效的多任务操作，这对人工智能驱动的应用至关重要。

Ferri-UFS® 通过支持宽温范围和多种存储容量，广泛适用于汽车、工业系统、嵌入式设备和便携式解决方案等多个领域。其简化的整合流程确保了快速部署，使 Ferri-UFS® 成为高性能、人工智能驱动嵌入式系统的理想选择。

Ferri-UFS® 广泛应用于汽车领域，包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)/自动驾驶、车载信息娱乐系统 (IVI)/智能驾驶舱和 V2X 系统，并严格遵守汽车行业标准，如 AEC-Q100 三级认证、IATF 16949 供应链合规性认证以及车用维修包 (ASP)。Ferri-UFS® 拥有较低的 dPPM 率和更长的产品生命周期，特别适用于汽车环境。其可定制的固件使其能够灵活适应各种特定的使用场景。

特点

高效纠错

- 先进的硬件 LDPC (ECC) 引擎
- StaticDataRefresh™ 和 EarlyRetirement™ 技术确保数据可靠性

功率效率

- 动态电源管理技术可提供多个省电模式

先进的全区磨损均衡 (Global Wear Leveling) 技术提高可靠性

- 在所有使用的 NAND Flash 组件间，平均分布写入/擦除次数
- 低写入放大指数 (WAI)，延长产品使用期限

强大的数据保护

- 多用户数据安全区
- PowerShield™ 和 DataPhoenix™ 技术可防止突然断电时的数据损坏

车用制程和认证

- AEC-Q100 认证
- IATF 16949 供应链合规认证
- 车用维修包 (ASP)

Ferri-eMMC®

工业/车用 eMMC 内存



随着人工智能在汽车、智能医疗、智慧城市、智能零售、工业自动化和 AIoT（智慧物联网）等领域的迅速发展，对可靠且超低功耗存储解决方案的需求显著增长，尤其是在车载信息娱乐系统 (IVI)、工业手持设备、工业 VR 和工业穿戴设备等移动和便携式设备领域。Ferri-eMMC® 搭载慧荣科技独有的 IntelligentSeries™ 技术，专为满足人工智能驱动应用日益增长的需求而设计，提供数据完整性、耐用性、功率效率和安全性等功能，使其成为在苛刻环境下应用的可靠选择。

与 UFS 相比，eMMC 的功耗显著降低。UFS 的功耗范围为 400mA (UFS 2.2) 至 800mA (UFS 3.1)，而 eMMC 的功耗范围仅为 70-100mA。此外，许多传统 CPU 不支持 UFS，仅依赖于 eMMC，这使得 eMMC 成为此类系统的首选。eMMC 还提供了较高的性价比，成为入门级嵌入式产品的理想选择。

Ferri-eMMC® 完全符合 JEDEC eMMC 5.1 标准，适用于广泛的嵌入式应用。它可提供 100-ball 和 153-ball BGA 封装，易于整合和生产，具备成本效益。Ferri-eMMC® 采用业界认证的主控芯片技术和高品质 NAND 组件，确保关键系统的数据存储可靠性。其先进的 NAND 管理功能（包括纠错、坏块管理和运行状况监控），确保长期的耐用性和可靠性。

Ferri-eMMC® 支持宽温范围，提供最高 256GB 存储容量，具备超低功耗和出色的可靠性，是在苛刻环境下使用的理想选择。它为人工智能、工业自动化和汽车应用领域提供了一个高性价比、低功耗的存储解决方案，因为在这些应用领域中，可靠性、耐用性和能效是至关重要的。

Ferri-eMMC® 广泛应用于车载信息娱乐 (IVI) 系统，符合严格的汽车行业标准，如 AEC-Q100 三级认证、IATF 16949 供应链合规认证和车用维修包 (ASP) 认证。Ferri-eMMC® 拥有较低的 dPPM 率和较长的产品生命周期，非常适合汽车应用。其可定制的固件还为各种特定应用提供了灵活性。

特点

高效纠错

- 先进的硬件 LDPC (ECC) 引擎
- StaticDataRefresh™ 和 EarlyRetirement™ 技术确保数据可靠性

功率效率

- 动态电源管理技术可提供多个省电模式

先进的全区磨损均衡 (Global Wear Leveling) 技术提高可靠性

- 在所有使用的 NAND Flash 组件间，平均分布写入/擦除次数
- 低写入放大指数 (WAI)，延长产品使用期限

强大的数据保护

- 多用户数据安全区
- PowerShield™ 和 DataPhoenix™ 技术可防止突然断电时的数据损坏

车用制程和认证

- AEC-Q100 认证
- IATF 16949 供应链合规认证
- 车用维修包 (ASP)

选购指南

FerriSSD
PCIe Gen4 x2/4 NVMe 2.0

单芯片 SSD

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
SM681GXD C8VP	128GB	120GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXE C8VP	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXF C8VP	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXG C8VP	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GED C8VP	128GB	120GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEE C8VP	256GB	240GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEF C8VP	512GB	480GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEG C8VP	1024GB	960GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXD C8VO	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXE C8VO	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXF C8VO	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXG C8VO	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GED C8VO	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEE C8VO	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEF C8VO	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEG C8VO	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less

模块

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
MD681GXDBC82P	128GB	120GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXEBC82P	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXFBC82P	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXGBC82P	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEDBC82P	128GB	120GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEEBC82P	256GB	240GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEFBC82P	512GB	480GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEGBC82P	1024GB	960GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXDBC82O	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXEBC82O	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXFBC82O	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXGBC82O	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEDBC82O	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEEBC82O	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEFBC82O	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEGBC82O	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXDBC82P	128GB	120GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXEBC82P	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXFBC82P	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXGBC82P	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEDBC82P	128GB	120GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEEBC82P	256GB	240GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEFBC82P	512GB	480GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEGBC82P	1024GB	960GB	V8 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXDBC82O	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXEBC82O	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXFBC82O	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXGBC82O	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEDBC82O	128GB	40GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEEBC82O	256GB	80GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEFBC82O	512GB	160GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEGBC82O	1024GB	320GB	V8 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less

FerriSSD
PCIe Gen3 x2 NVMe 1.3

单芯片 SSD

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
SM681GXC AGST	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXD AGST	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXE AGST	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXF AGST	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEC AGST	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GED AGST	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEE AGST	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEF AGST	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXC AGSS	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXD AGSS	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXE AGSS	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GXF AGSS	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEC AGSS	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GED AGST	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEE AGSS	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less
SM681GEF AGSS	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / DRAM-less

模块

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
MD681GXCKAG3T	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXDAG3T	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXEKAG3T	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXFAG3T	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GECKAG3T	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEDKAG3T	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEEKAG3T	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEFKAG3T	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXCKAG3S	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXDAG3S	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXEKAG3S	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GXFAG3S	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GECKAG3S	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEDKAG3S	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEEKAG3S	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
MD681GEFKAG3S	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x42 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXCKAG3T	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXDAG3T	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXEKAG3T	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXFAG3T	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GECKAG3T	64GB	60GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEDKAG3T	128GB	120GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEEKAG3T	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEFKAG3T	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXCKAG3S	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXDAG3S	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXEKAG3S	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GXFAG3S	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GECKAG3S	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEDKAG3S	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEEKAG3S	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less
ME681GEFKAG3S	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	M.2 22x80 mm w/ M-key	Single Chip BGA SSD on module / DRAM-less

FerriSSD

SATA 6Gb/S

单芯片 SSD

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
SM619GXC DGST	64GB	64GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXD DGST	128GB	128GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXE EGST	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXF EGST	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEC DGST	64GB	64GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GED DGST	128GB	128GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEE EGST	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEF EGST	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXC DGSS	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXD DGSS	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXE EGSS	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GXF EGSS	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	c-temp: 0°C to 70°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEC DGSS	64GB	20GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GED DGSS	128GB	40GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEE EGSS	256GB	80GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM
SM619GEF EGSS	512GB	160GB	BiCS5 3D SLCmode	i-temp: -40°C to 85°C	16x20 mm BGA	Single Chip BGA SSD / w/ DRAM

模块

产品	容量	可用容量	NAND	温度范围	外形规格	备注
ME619FXEOF7	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619DXFOFA7	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619DXGOF7	1024GB	960GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619DXHOF7	2048GB	1,920GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619FXEOF7	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619DXFOFA7	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619DXGOF7	1024GB	960GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619DXHOF7	2048GB	1920GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619HXEOF7	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
ME619HXFOFA7	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
ME619HXGOF7	1024GB	960GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXEOF7	256GB	240GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXFOFA7	512GB	480GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXGOF7	1024GB	960GB	BiCS5 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
ME619FXEPF87	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619DXFPF87	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619DXGPF87	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619FXEOF87	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619DXFOF87	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
MA619DXGOF87	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=1 / w/ DRAM
ME619HXEPF87	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
ME619HXFPF87	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
ME619HXGPF87	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	M.2 2280mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXEOF87	256GB	240GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXFOF87	512GB	480GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM
MA619HXGOF87	1024GB	960GB	V8 3D TLC	c-temp: 0°C to 70°C	2.5" 7mm w/ PLP	Discrete controller + NAND DWPD=3 / w/ DRAM

模块

Ferri-UFS

UFS 3.1

产品	容量	NAND	外形规格	温度范围
SM671PXC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PEC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PED BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PEE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PEF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PAC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PBC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C

UFS 2.2

产品	容量	NAND	外形规格	温度范围
SM671PXCLBFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXDLBFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXELBFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PXFLBFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM671PECLBFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PEDLBFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PEELBFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PEFLBFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM671PACLBFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PADLBFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAELBFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAELBFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PAFLBFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM671PBCLBFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBDLBFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBELBFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM671PBFLBFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C

Ferri-eMMC

eMMC 5.1

产品	容量	NAND	外形规格	温度范围
SM662GX8 C4V	8GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXA C4V	16GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXB C6V	32GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXC BFS	64GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXD BFS	128GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXE BFS	256GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GXF BFS	512GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662GE8 C4V	8GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GEA C4V	16GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GEB C6V	32GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GEC BFS	64GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GED BFS	128GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GEE BFS	256GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GEF BFS	512GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662GA8 C4V	8GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAA C4V	16GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAB C6V	32GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAC BFS	64GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAD BFS	128GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAE BFS	256GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GAF BFS	512GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662GB8 C4V	8GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBA C4V	16GB	2D MLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBB C6V	32GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBC BFS	64GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBD BFS	128GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBE BFS	256GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662GBF BFS	512GB	3D TLC	100b BGA 14x18mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PX8 C4V	8GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXA C4V	16GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXB C6V	32GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PXF-BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	C-temp: -25°C to 85°C
SM662PE8 C4V	8GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PEA C4V	16GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PEB C6V	32GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PEC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PED BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PEE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PEF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	i-temp: -40°C to 85°C
SM662PA8 C4V	8GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAA C4V	16GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAB C6V	32GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PAF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade3: -40°C to 85°C
SM662PB8 C4V	8GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBA C4V	16GB	2D MLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBB C6V	32GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBC BFS	64GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBD BFS	128GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBE BFS	256GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C
SM662PBF BFS	512GB	3D TLC	153b BGA 11.5x13mm	Auto-grade2: -40°C to 105°C

联系我们

台北	231003 新北市新店区北新路一段 86 号 26 楼 电话 : +886-2-22196688 传真 : +886-2-22196868
竹北	302052 新竹县竹北市复兴三路二段 162 号 电话 : +886-3-5526888 传真 : +886-3-5526988
Milpitas	690 N. McCarthy Blvd. Suite 200, Milpitas, CA 95035, USA 电话 : +1-408-519-7200 传真 : +1-408-519-7101
Shin-Yokohama	LIVMO Rising Bldg. 4F, 3-19-1, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 222-0033 Japan 电话 : +81-45-478-5220 传真 : +81-45-478-5212
Seongnam-si	1F, Bld B, SiliconPark, 35, Pangyo-ro 255 beon-gil (Sampyeong-dong), Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13486 Korea 电话 : +82-31-782-3880~2 传真 : +82-31-778-8489
深圳	深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 9F 邮编: 518040 电话 : +86-755-8204-9580
上海	上海市杨浦区荆州路 168 号安联大厦 8 楼 邮编: 200082 电话 : +86-21-6510-7780 传真 : +86-21-6510-7821
北京	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 A 座 507 室 电话 : +86-010-6471-8549 传真 : +86-010-6471-9546
香港	香港上环苏杭街 19-25 号永昌商业大厦 19 楼 C 室 电话 : +852 2307 4768

要了解更多有关 Ferri 系列的信息, 请访问
www.siliconmotion.com 或发送电子邮件至 ferri@siliconmotion.com

欢迎关注我们的社交媒体，获取最新产品资讯！



LinkedIn



Facebook



WeChat

本文档中的信息按“现状”提供，慧荣科技不对其作任何明示或暗示的保证，包括但不限于关于信息的完整性、准确性、适销性、特定用途适用性、用于监管应用的适宜性或侵权性的保证。慧荣科技保留随时更新或修改本文档或其中所描述产品的权利，恕不另行通知。

在任何情况下，慧荣科技及其关联公司均不对因使用或与使用本文档中信息相关所引起的任何直接、间接、特殊、附带或后果性损害承担责任，包括但不限于使用权丧失、数据丢失、利润损失或业务中断。即使慧荣科技或其授权代表已被告知发生此类损害的可能性，该等责任亦不成立，无论该责任基于合同、严格责任或侵权行为。

本文档所含信息不构成对任何版权、商标、专利或其他知识产权的授权。